

技術詞彙表

本技術詞匯表載有本文件所用與本公司及我們的業務有關的若干技術詞匯的解釋。該等詞匯及涵義可能與其標準行業涵義或用法不同。

「5G」	指	一項旨在取代4G的移動通信標準，可實現更高速度的無線互聯網接入
「6G」	指	繼5G之後的下一代蜂窩式技術，通過集成AI、傳感和量子計算等技術，有望實現顯著更快的速度、更低的延遲（低至微秒級）、更高的容量和更強大的智能
「AI」	指	人工智能
「負極集流體」	指	一種高導電性金屬箔，用作負極活性材料的結構支撐及導電通路，將其連接到電池外部電路，以促進充電及放電期間的電子流動
「汽車電子」	指	應用於車輛的電子系統，包括發動機管理、點火系統、收音機、車載電腦、遠程信息處理系統、車載娛樂系統等
「電池能量密度」	指	電池相對於其重量或體積所儲存的能量，表示在緊湊輕巧的封裝中可容納多少能量
「CAGR」	指	年複合增長率
「陰極銅」	指	高純度精煉銅
「陰極輓筒」	指	用於生產鋰電池電極和電解銅箔的關鍵部件，通常為一個大型精密加工的圓柱體（通常由鈦銅鋼複合材料製成），作為金屬離子鍍覆以形成均勻箔層的陰極表面
「CCL」	指	覆銅箔層壓板。印刷電路板製造中的基礎印刷電路板基板，其應用最為廣泛，可用於製造電路板
「電子電路銅箔」	指	一種薄而柔韌的純銅片，用作PCB和其他電子元件中的導電層。由於銅具有優良的導電性和延展性，它形成傳輸電信號、連接元件和散熱的通路

技術詞彙表

「電解銅箔」	指	一種金屬箔材料，通過電解硫酸銅溶液，將銅離子沉積在陰極上製成
「儲能系統」	指	於某一時間捕獲所產生的能量，以供日後使用，從而減少能源需求與能源生產之間的不平衡
「ERP」	指	企業資源規劃
「eVTOL」	指	電動垂直起降飛行器
「FR-4(Tg-140)」	指	一種標準等級的阻燃環氧玻璃布層壓板(FR-4)，其玻璃化轉變溫度(Tg)約為140°C
「GFA」	指	總樓面面積
「GWh」	指	吉瓦時。一個大型電能單位，代表十億瓦時或一百萬千瓦時
「HDI」	指	高密度互聯。生產PCB所使用的尖端技術
「HF」	指	無鹵素
「高性能計算」	指	一種利用強大的處理器集群並行處理海量、多維度數據集並以極高速度解決複雜問題的技術
「高速通信」	指	利用光纖、5G、6G及先進的無線／有線協議等技術實現的快速數據傳輸，通過克服對高要求應用(如遠程手術和數字孿生)中的延遲和帶寬限制，使實時多媒體和遠程操作成為可能
「Hi-Tg」	指	高玻璃化轉變溫度
「HTE」	指	高溫延伸率
「HVLP」	指	超低輪廓箔。一種高度專業化、異常光滑的銅箔，厚度通常僅數微米，專為高頻高速電子產品(例如5G/6G)而設計，以盡量減少信號損耗。通過控制晶體結構，其表面粗糙度一般低於2.5微米，此特性對高速數據傳輸至關重要，因傳統粗糙銅箔會因趨膚效應而增加電阻

技術詞彙表

「IPD」	指	集成產品開發，一套結構化的產品開發及質量控制體系，透過整合跨職能團隊、標準化階段門流程及全生命週期管理，提高開發效率、降低風險，並確保產品自概念構思至商業化過程中的質量
「鋰電池」	指	一種高效及可充電的儲能設備，用作支持電動交通、新型電力系統及其他領域的能源轉型的核心基礎
「鋰電銅箔」	指	鋰電池的關鍵功能性組件，用作負極集流體
「低翹曲」	指	材料或部件在製造過程中或之後幾乎不發生偏離其設計幾何形狀或平整度的變形狀態，表明其內部應力及熱效應得到了有效控制
「MPa」	指	兆帕。國際單位制中壓力或應力的單位
「mm」	指	毫米
「MOM」	指	製造運營管理
「新能源材料」	指	專為可再生能源技術而研製的先進物質，用以有效收集、轉換、儲存及使用能源，以取代化石燃料
「PCB」	指	印刷電路板。電子行業的核心材料，支持電子產品向更高性能、小型化和智能化方向發展
「剝離強度」	指	以特定角度和速度分離兩個粘貼在一起的材料所需的單位寬度力，用於衡量粘合劑的粘合強度
「多孔銅箔」	指	一種具有三維多孔結構的高表面積銅材料
「Ra」	指	算術平均粗糙度，表示表面的整體平均粗糙度
「RTF」	指	反向處理電解銅箔。一種兩面均經不同程度粗化處理的銅箔
「Rz」	指	十點平均粗糙度，表示表面極端峰谷高度，對偶發性刮痕、凹坑或缺陷更為敏感

技術詞彙表

「研發」	指	研究與開發
「六西格瑪」	指	一種以數據為驅動的業務管理方法，旨在減少流程變異及消除缺陷。其目標是通過確保流程每百萬次機會中產生不超過3.4個缺陷，實現近乎完美的質量水準。該方法依賴統計工具及結構化的問題解決框架，以提升營運效率及客戶滿意度
「固態電池」	指	一種使用固態電解質在電極之間傳導離子的電池，而非傳統電池中使用的液態或凝膠狀聚合物電解質
「m ² 」	指	平方米
「抗拉強度」	指	材料在拉伸或牽引下斷裂或永久變形前所能承受的最大應力
「μm」或「微米」	指	微米